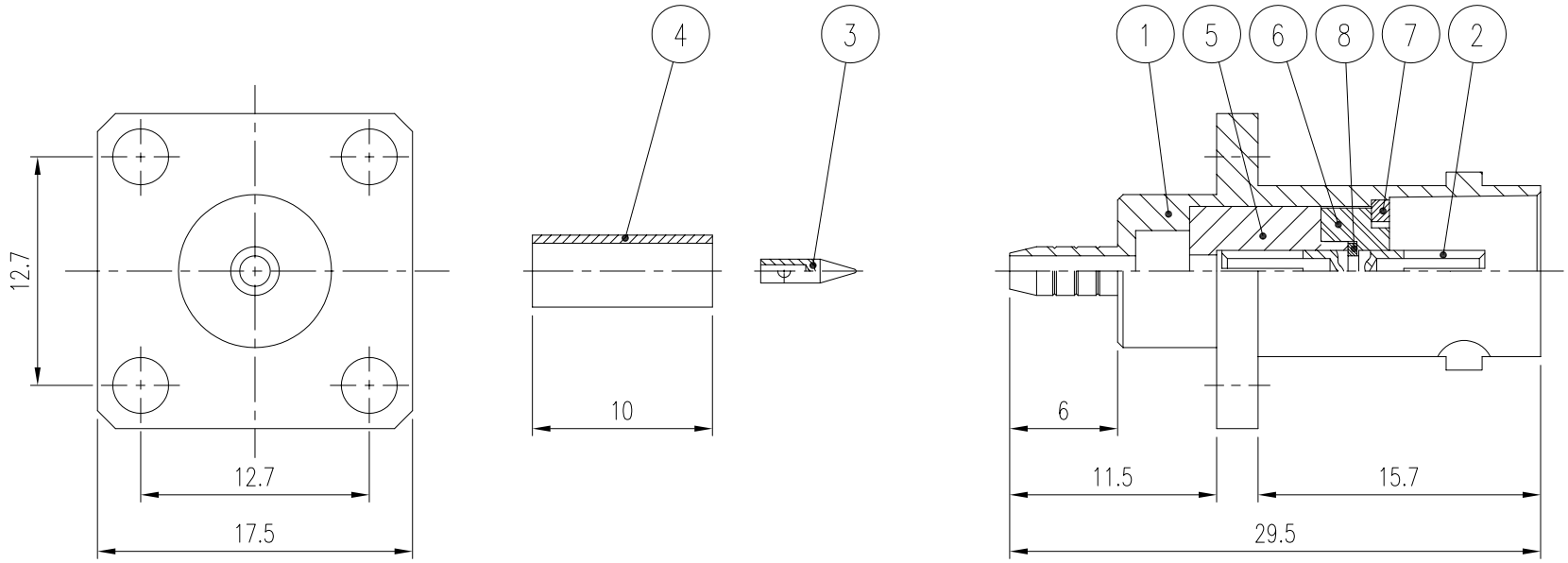
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
8	고정 RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00048-5/1 (L6009)
7	고정 RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00051-5/1 (L7009)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00589-N/1 (H6409)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00425-N/1 (H6051)
4	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00034-5/1 (F2017)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00462-5/1 (E6017)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00479-5/1 (E6016)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00627-5/1 (D6024)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2000. 2. 24.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 6/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 BNC-JC-179

A4

도번 CN00354-7/1

K327-236-000